

Automatické sítotisky

technické specifikace

Parametr	Specifikace
Přesnost a opakovatelnost stroje	> 2.0 Cmk @ $\pm 12.5 \mu\text{m}$, (6 sigma)*
Přesnost a opakovatelnost procesu	> 2.0 Cmk @ $\pm 25 \mu\text{m}$, (6 sigma)**
Základní čas cyklu	11 s (8 s)
Operační systém	Windows 7 Standard embedded
Mechanismus stěrek	softwarově ovládaný, motorický se zpětnou vazbou
Zakládání šablony	ruční nebo poloautomatické
Nastavitelná šířka šablony	libovolně nastavitelná šířka rámu šablony v rozsahu 381 mm až 736 mm, tloušťka rámu 25 mm až 38 mm
Čištění spodní strany šablony	"DEK Interchangeable under stencil cleaner" (DEK IUSC), plně programovatelný se suchým, mokrým a vakuovým čištěním
Velikost DPS	50 mm (X) \times 40,5 mm (Y) až 501 mm (X) \times 508,5 mm (Y)
Tloušťka DPS	0,2 mm až 6 mm
Hmotnost DPS	do 6 kg
Vytvoření programu	méně než 10 min
Uchycení DPS	horní, boční (variantně), vakuum (variantně)
Teplotní a vlhkostní senzor	monitoring vnitřního prostoru stroje
Kontrola nanesené pasty	Hawkeye 750 (variantně)